

GX112 兼容 SMBus 和 I²C 通信的高精度、低功耗数字温度传感器

1 基本性能

- 产品编号: **GX112S**、**GX112D**
- 测温范围: **-55°C ~ +150°C**
- 测温精度: **±0.5°C (-40°C ~ +125°C)**
- 封装形式: **6-Pin SOT563 (GX112S)**
6-Pin DFN6 (GX112D)
- 封装尺寸: **1.60 mm × 1.60 mm**
- 电源电压: **1.4V ~ 5.5V**
- 低静态电流
正常工作: **≤10μA (4Hz)**
关断模式: **≤1μA**
- 分辨率: **12bits、0.0625°C**
- 数字输出: **兼容SMBus、I²C接口**

2 应用场景

- 便携式、电池供电应用
- 电源温度监控
- 电脑外部设备热保护
- 笔记本电脑
- 电池管理
- 办公机器
- 恒温控制
- 机电设备温度
- 一般温度测量:
 - 工业控制
 - 测验设备
 - 医疗仪器

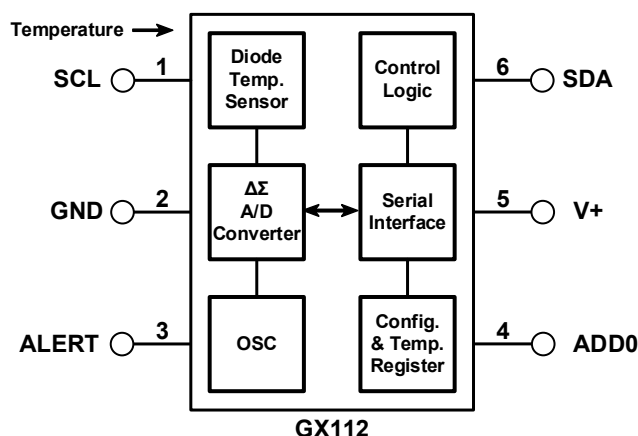
3 芯片概述

GX112是一款高精度、低功耗、可替代NTC / PTC热敏电阻的数字温度传感器，可用于通信、计算机、消费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。GX112在-40°C至+125°C的正常工作范围内，可提供≤±0.5°C的温度精度，并具有良好的温度线性度。GX112可提供扩展测温模式，将测温范围扩展为-55°C至+150°C。

GX112的额定工作电压范围为1.4V~5.5V，在整个工作范围内最大静态电流为10μA（测温频率4Hz）。集成在芯片内部的12位ADC分辨率低至0.0625°C。

GX112采用1.6mm×1.6mm的SOT563 / DFN6封装，兼容SMBus和I²C接口，在一条总线上最多可挂载四个从机，并具有SMBus报警功能。

图 1 GX112 内部各模块示意图



9 订购信息

订购编号	芯片型号	封装信息	标准包装数量	备注
GX112D-T&R	GX112D	DFN6	4000	卷带包装 (Tape & Reel)
GX112S-T&R	GX112S	SOT563	3000	卷带包装 (Tape & Reel)